

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-012

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（<u>电话会议</u>）
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2025 年 10 月
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、CTO 徐玉鹏先生；财务总监、副总经理金良凯先生；董事会秘书、副总经理李大林先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、第三季度公司经营情况介绍？ 整体而言，2025 年前三季度，随着全球终端消费市场持续回暖，产业链去库存周期基本结束，叠加 AI 应用场景不断涌现，集成电路行业整体景气度维持在较高水平。2025 年前三季度，得益于海外大客户的持续放量和国内核心端侧 SoC 客户群的成长，公司实现营业收入 31.70 亿元，同比增长 24.23%，其中第三季度单季度营收 11.60 亿元，同比增长为 25.76%，环比增长 9%，刷新 Q2 记录，再创公司单季度营收的历史新高。前三季度实现归属于上市公司所有者的净利润 6,312 万元，较上年同期增长 48.87%，2025 年 Q3 三季度扣非后归母净利润回正，实现扭亏为盈。毛利率方面，规模效应逐渐体现，前三季度度公司整体毛利率达 16.42%，今年前三个季度的毛利率分别为 14.19%、16.87%和 17.82%，整体呈逐步上涨。期间费用方面，公司在产品结构和成本管控方面的优势逐

	步凸显,今年前三季度的管理费用率从去年同期的 7.76% 下降到 6.24%, 财务费用率从去年同期的 6.02%下降到 5.15%, 我们相信随着公司营收规模的持续提升, 期间费用率特别是管理费用率会持续下降, 规模效应进一步显现。研发投入方面, 公司持续投向先进封装领域, 今年前三季度研发投入同比增长 41.72%, 占比营收 6.92%。 产品结构方面, 前三季度系统级封装产品营收占比约 41.16%, QFN 营收占比约为 38.41%, FC 产品营收占比约 15.59%, 晶圆级封装产品营收占比约 4.34%。公司各产品线的营收都有所增长, QFN、FC 和晶圆级产品的增长速度较为突出, FC 和晶圆级封装产品是公司二期项目主要投资方向, 今年前三季度晶圆级封装产品营收增长同比翻倍, 达到 1.36 亿元。从应用领域来看, AIoT 占比超过六成, 增速超过 30%, PA 和安防各占比约一成, 运算和车规产品合计占比 10%左右, 其中车规产品增速较快, 同比增长达到 204.03%。客户结构方面, 前三季度海外大客户营收同比增速较快。 新产品布局方面, 公司在 2.5D 产线的进展整体较为顺利, 目前在与客户做产品验证, 正在按照既定节奏推进。技术储备方面, 公司目前已打造 HCOS 系列封装平台, 全面覆盖了 OR、硅转接板及硅桥方案, 为公司后续发展奠定技术基础。 2、稼动率情况? 公司前三季度稼动率维持高位水平, 如 QFN、FC 等产品线均处于满产状态。 3、价格变动趋势? 一方面, 受材料价格上涨的影响, 产品价格可能会因此上涨; 另一方面在产能饱和情况下客户可能为缩短交期而主动溢价。
--	--

	4、第四季度及明年收入预期？ 随着海外大客户持续放量和国内核心端侧 SOC 客户群成长，第四季度及明年营业收入将保持增长趋势。 5、资本开支情况？ 公司已审议的 2025 年资本开支规模在 25 亿元以内，较 2024 年保持稳定，主要投向包括现有产品线产能扩张、晶圆级封装及 2.5D、FC-BGA 等先进封装领域。 6、先进封装技术布局情况？ 公司坚定践行技术创新战略，以前瞻性布局切入先进封装领域，基于自有的 Chiplet 技术推出了 FH-BSAP（Forehope-Brick-Style Advanced Package）积木式先进封装技术平台。涵盖 RWLP 系列（晶圆级重构封装，Fan-out 扇出封装）、HCOS 系列（2.5D 晶圆级/基板上异构封装）、Vertical 系列（晶圆级垂直芯片堆栈封装）等，精准适配 Fan-out（FO）、2.5D/3D 先进晶圆级封装等多元化先进封装技术需求。 7、海外业务营收展望？ 基于目前政策环境，海外客户有寻求供应链本土化的考量。随着与现有海外客户的深入合作以及新的海外客户的拓展，未来海外营收增速预计将会超过公司整体营收增速。 8、未来主要利润增长点？ 随着营收规模扩张，规模效应显现，产能利用率提升，单位成本下降，同时期间费用不会随收入线性增长，从而对利润形成正向贡献；折旧方面，随着早期投入的设备折旧陆续结束，利润将逐步释放；产品结构方面，公司先进封装产品占比持续提高，将会继续对利润产生正向影响。 9、下游应用领域占比？
--	---

	从应用领域来看，AIoT 占比接近 70%，增速超过 30%；PA 和安防各占比约为 10%，运算和车规产品合计占比 10%左右。 10、封测一体化方案情况？ 公司致力于打造成为最具竞争力的一站式 Turnkey 封测基地，而公司也具备“Bumping+CP+FC+FT”的一站式交付能力。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 10 月 30 日

注：公司严格遵守信息披露相关规则与投资者进行交流，如涉及公司战略规划等意向性目标，不能视为公司或管理层对公司业绩的保证或承诺，敬请广大投资者注意投资风险。